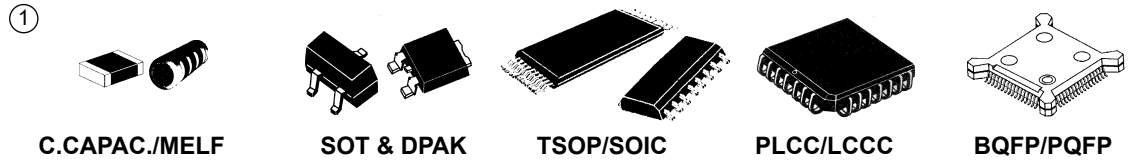
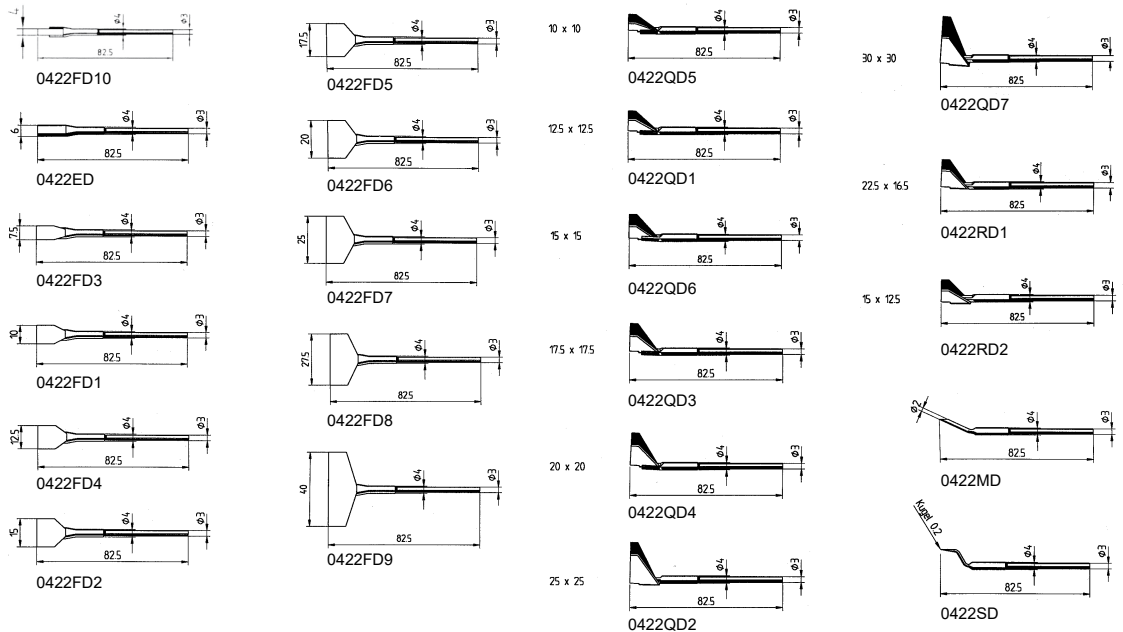


SMD Entlöten mit Kontaktwärme



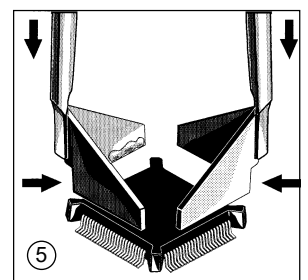
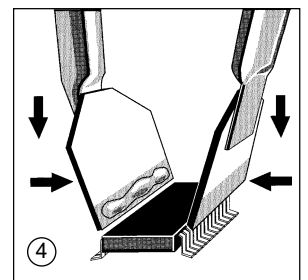
ERSADUR Entlötspitzen Serie 422

②

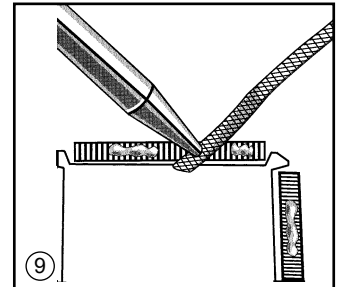
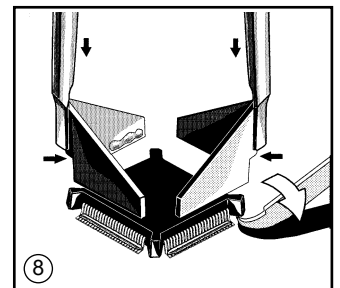
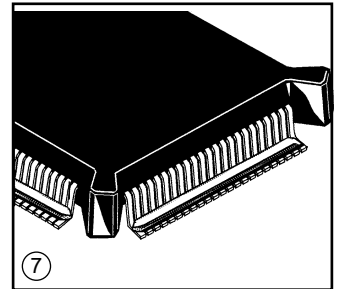
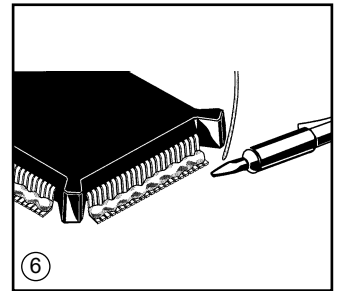


Prozessbeschreibung

1. Wählen Sie ein gereinigtes Entlötspitzenpaar ② entsprechend Ihrem Bauteil ① aus dem Löt- und Entlötspitzenhalter SMD 8012 aus. Montieren Sie diese auf der Entlöt-Pincette 40 ③ und richten Sie die Spitzen anschließend aus.
2. Stellen Sie die Spitzentemperatur zwischen 300°C und 320°C ein. Vergleichen Sie die eingeprägte Nummer auf der Lötspitze mit der Temperaturtabelle in Ihrer Betriebsanleitung. ④
3. Tragen Sie das Lot auf den Entlötspitzen auf, bis sich ein kleines Lot-depot angesammelt hat. Das Lot sollte nicht von den Spitzen tropfen!
4. Tragen Sie das Flußmittel auf das zu entlötende Bauteil auf.
5. Halten Sie die Pincette 40 locker in der Hand und senkrecht zur Leiterplatte. Senken Sie die Entlötspitzen auf die gelöteten Anschlüsse ab. ⑤ ⑥
6. Schließen Sie die Pinzette vorsichtig und drücken Sie diese leicht auf die Leiterplatte. Bitte beachten Sie, daß die Spitzen alle Pins gleichzeitig kontaktieren. Mit dieser Bewegung erreichen Sie eine optimale Wärmezufuhr auf allen Seiten des SMD. Auf diese Art und Weise sollte es Ihnen möglich sein, das SMD-Bauelement innerhalb von 1-3 Sekunden zu entlöten. ⑤ ⑥



7. Sollte das SMD-Bauteil nach 3 Sekunden nicht entlötet sein, wenden Sie keine Kraft an!
Nehmen Sie die Pinzette wieder vom SMD-Bauteil weg.
8. Wiederholen Sie die Punkte 3 und 6. Sollte das SMD-Bauteil noch nicht entlötet sein, wenden Sie keine Kraft an!
Nehmen Sie die Pinzette wieder vom SMD-Bauteil weg.
9. Bereiten Sie das SMD-Bauteil für eine bessere Wärmeübertragung vor. Tragen Sie an allen vier Seiten des SMD-Bauteils Lot auf die Anschlußbeine auf, durch Verwendung der „Brückentechnik“ ⑦ oder durch Benutzung einer „Wire-Wrap Technik“ ⑧
10. Wiederholen Sie die Punkte 3 und 6. Sollte das SMD-Bauteil noch nicht entlötet sein, wenden Sie keine Kraft an!
Nehmen Sie die Pinzette wieder vom SMD-Bauteil weg.
Vorsicht: SMD-Bauteil ist evtl. geklebt.
11. Wiederholen Sie Punkt 9. Benutzen Sie eine hakenförmig gebogene Pinzette, um dann anschließend durch eine Hebelbewegung unter eine Ecke des geklebten SMD-Bauteiles zu gelangen. ⑨
Wiederholen Sie nun Punkt 3 und 6 und hebeln Sie die Ecke mit der Pinzette an. Durch diese diagonale Kraft lassen sich nahezu alle Klebepunkte lösen.
12. Entfernen und reinigen Sie die alten Rückstände mit der ERSA Entlötlitze WICK. ⑩
13. Sie können nun ein neues SMD-Bauteil einlöten. Hierzu beachten Sie bitte unsere Prozeßbeschreibung: FINE-PITCH-INSTALLATION.



Empfohlene Ausrüstung:

Bezeichnung	Best.-Nr.
i-CON1 V – Einzelstation	01C1100V
i-CON2 V* – Doppelstation	01C2200V
ERSA Entlötspitzen	Serie 422
ERSA Chip TOOL	0450MDJ

Zubehör:

Type	Best.-Nr.
Flussmittelcreme	0FMKANC32-005
Lötendraht	010MM0250LF02
Fluxremover	0FR400
Entlötlitze	0WICKNC 1.5/10, 2.2/10 oder 2.7/10